

性能特点

- 材料达到相变温度后硬度显著降低
- 具有自粘性，贴合性好
- 达到相变温度后，材料非流体状，不会溢出
- 应力低，更为有效地保护电器元件

产品描述

PAKCOOL®SPC-7630 导热相变垫片在设计上成功融合了导热性和相变性的优势。其特点是使导热垫片在达到相变温度以后，硬度显著降低，表面自粘性增强，有效填充热源与散热器之间的空隙，确保优异的热传导效果，并且其相变后的非流体状态避免了高温下材料溢出的问题。与传统导热垫片相比，该产品在达到相变温度以后，在相同压力下具有更低的热阻。本产品压强 20-100 psi (0.14-0.69 MPa) 的压力下具有最佳导热性能。产品规格灵活，可根据客户需求定制尺寸。

本产品在其表面具有一定的黏性。在使用时无需附加其他影响导热性能的粘合剂从而更便于大规模生产加工。在所有的垫片的两面都附有易剥落的防尘薄膜。

技术参数

特性	SPC-7630	测试方法
颜色	灰色	目测
导热系数 (W/m·K)	3.0±0.1	ASTM D5470
热阻@20psi, 0.5mm (K·in ² /W)	0.34	ASTM D5470
厚度* (mm)	0.3—5.0	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	2.95±0.05	ASTM D792
硬度@25°C (Shore OO)	50±10	ASTM D2240
相变温度 (°C)	42-52	DSC
体积电阻率 (Ω·cm)	≥2.0×10 ¹³	ASTM D257
连续使用温度 (°C)	-40~100	--
*标准厚度 (mm): 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5		

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

典型应用

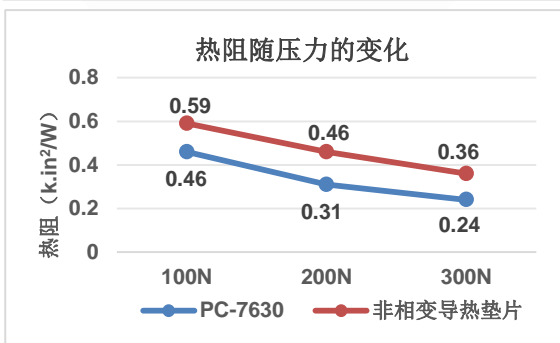
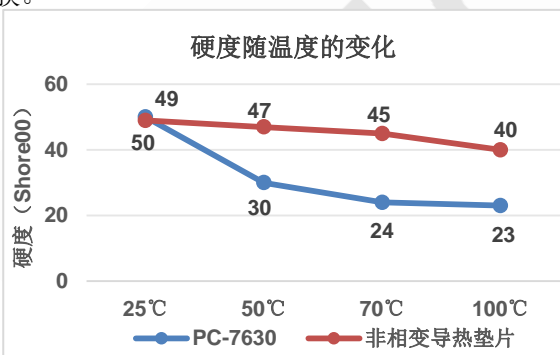
- 高功率 LED、通讯设备、无线基站
- 储存模块和芯片
- 高端计算机等散热要求高的应用

产品配置

- 尺寸可根据客户的要求进行裁切
- 无背胶

包装储运

- 常温、通风干燥处保存、避免阳光直射
- 建议储存期限：24 个月



本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。